

これまでの
導入事例

製品開発領域は



■ = 用途

— = 特長

カスタムディスペンシング



耐熱仕様

メタルシリンジ

[1] × [A+B+J]

通信デバイス搭載部品



小径穴安定量産

調光部材

[1] × [A+B]

医療用部品



チタン微細加工

マイクロニードル

[8] × [A]

「こうしましよ。」
精密機械加工技術
カタログ

あなたの想いを カタチにする 製造業です

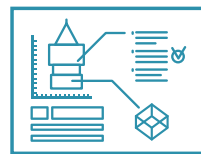
テクダイヤは「加工技術で産業界の常識を覆す」というモットーのもと、精密機械加工技術・ダイヤモンド加工技術をコアに先端技術を支えています。既存製品の枠にとらわれず挑戦を続け、通信、医療、航空宇宙など様々な業界に製品提供しています。

提案・開発・量産まで一貫して行います

テクダイヤは、設計・開発から量産まで一貫して行う「ワンストップ・サービス」で、短納期・低価格な製品提供を実現します。

ヒアリング・提案

簡単な加工から新製品開発まで、材料や形状、数量などのご要望をお聞かせください。テクダイヤならではの「こうしましょう。」をご提案します。



開発・試作

様々な材料の加工実績から培ったノウハウと技術力を活かし、ご要望に合う最適な加工方法で対応。図面以上の精度を実現します。



評価・改善

お客様からの評価を受け、営業部・技術部・品質保証部が一体となって、改善を行います。評価と改善を繰り返し、より良い製品をつくり上げていきます。



量産

量産はフィリピン・セブの自社工場で行い、小ロットから大量生産まで、安価でお応えします。量産後も改善や改良を行います。



要素技術一覧

装置	技術			材料
マシニングセンター	微細穴加工	極小径穴加工	φ0.030 mm (最長: 2.5 D)	SUS303
		小径穴加工	φ0.030 ~ φ0.090 mm (目安: 10 D)	
	一般穴加工	ドリル穴加工	φ0.10 ~ φ12.0 mm	SUS、鉄鋼、POM*、Ti、Alなど
		リーマ加工	φ2.0 ~ φ12.0 mm	
		タップ加工	M3 ~ M12	
エンドミル加工	外径切削加工	φ0.080 mm ± 0.005 mm	SUS303	
旋盤	微細穴加工	極小径穴加工	φ0.030 ~ φ0.090 mm	SUS303
		ドリル穴加工	φ0.10 ~ φ0.90 mm	SUS、鉄鋼、POM*、Ti、Alなど
	一般穴加工	穴加工	φ1.0 mm ~	SUS、鉄鋼、POM*、Ti、Alなど
		リーマ加工	φ3.0 mm ~	
		タップ加工	M3 ~ M10	
	微細加工	外径旋削加工	φ0.20 mm ± 0.02 mm (最長: 5.5D)	SUS303
研削盤	外周加工	テーパバービン	15° ~	SUS304、超硬合金、鉄鋼、真鍮、HSS、TY-100** など
		先端R加工	R = 0.010 mm ± 0.005 mm	
	工具内製	テーパバービン	15° ~	
		円柱外径加工	φ1.0 ~ φ10 mm ± 0.003 mm	
ソーイングマシン	切断加工	-	ダイヤモンド、サファイヤ、石英など	
ラッピングマシン	ラッピング加工	▽▽▽FL	SUS303、HPM38、ルビー	

加工/処理	技術		材料	
表面処理、熱処理など	撥液性付与	撥水コーティング	SUS、鉄鋼	
	その他機能性付与	焼き入れ	HPM38	
ガス軟室化				
接合	エポキシ接着	POM* + 金属、または 金属 + 金属	SUS、超硬合金、POM*	
	溶接	YAGレーザー スポット溶接	SUS	
	ろう付け	ダイヤモンド + 金属 ろう付け	ダイヤモンド、超硬合金、鉄鋼	
	セラミックボンド	-	ダイヤモンド、石英	
	カンメ加工	-	SUS	
	焼きばめ	ルビー + 金属接合	SUS、ルビー、超硬合金、鉄鋼	
圧入加工	-	SUS		
ダイヤモンド研磨	角錐加工	円錐加工	鋭角方向60°、先端フラット5 μm	ダイヤモンド
		四角錐加工	先端スレ: < 1 μm	
		三角錐加工	R = < 0.1 μm (100 nm)	
	先端加工	先端R加工	R = 10 μm ~ 1.0 mm	
		鋭角加工	40°	
	外周加工	薄板加工	t = 50 μm	
角柱加工		□100 μm またはそれ以上		

POM* = ポリオキシメチレン
TY-100** = Au - Pt - Pd - Ag系合金

[材料]と[加工技術]の掛け算でお応えします あなたの想いを、オリジナル製品で実現します

あらゆる精密機械加工技術で、様々な製品を提供してきました。

材料と技術の融合で、製品開発の可能性は**無限大**。お客様独自のカスタマイズにも対応します。

材料

- 1 SUS303
- 2 SUS304
- 3 **ルビー**
- 4 **ダイヤモンド**
- 5 TY-100
- 6 HSS
- 7 **超硬合金**
- 8 その他

技術

- A 微細加工
- B 微細穴加工
- C ラッピング加工
- D 工具内製
- E カシメ加工
- F 焼きばめ
- G ダイヤモンド研磨加工
- H ろう付け、接着
(金属 + ダイヤモンド、
金属 + 金属)
- I 微細研削加工
- J 圧入加工

これまでの導入事例 製品開発領域は∞

用途
特長

<p>自動車部品・水晶デバイス・LED・アクチュエーター組立 航空宇宙研究開発、医療試薬塗布</p> <p>ディスペンサースズル [1 or 8] × [A + B + C + D]</p> <p>この用途の特長： - 這い上がらない - 詰まらない - バラつかない</p>	<p>バイオマテリアルプリンティング</p> <p>精密ディスペンサースズル [1] × [A + B + C + D]</p> <p>この用途の特長： - 超精密塗布</p>	<p>3Dプリンティング</p> <p>3Dプリンターヘッド ノズル [1 or 8] × [A + B + C + D]</p> <p>この用途の特長： - 難削材高精度加工 - 小径対応可能</p>	<p>カメラモジュール組立</p> <p>先端スーパーロングノズル [1] × [A + B + C + D]</p> <p>この用途の特長： - 先端長さ穴径比24倍 - 狭小部塗布可能 - 干渉回避</p>	<p>液晶パネル組立</p> <p>ジェットノズル [1 or 8] × [A + B + C + D]</p> <p>この用途の特長： - 特殊形状</p>	<p>半導体デバイス組立</p> <p>マルチノズル [1] × [A + B + E]</p> <p>この用途の特長： - パイプ抜け、沈みなし</p>
<p>液晶パネル組立</p> <p>ルビースズル [1 + 3] × [A + B + F]</p> <p>この用途の特長： - 先端耐摩耗性</p>	<p>GaN/SiC他ウェハカット</p> <p>ダイヤモンドスクライバー [1 + 4] × [A + G + H]</p> <p>この用途の特長： - ドライカット - チップ集積率向上 - クラックコントロール</p>	<p>研究開発用ウェハカット</p> <p>ハンドスクライバー [1 + 4] × [A + G + H]</p> <p>この用途の特長： - 簡便・安価</p>	<p>硬度試験測定</p> <p>ダイヤモンド圧子 [1 + 4] × [A + G + H]</p> <p>この用途の特長： - 各種規格対応</p>	<p>水晶デバイスチップハンドリング</p> <p>ダイヤモンドピンセット [1 + 4] × [A + H]</p> <p>この用途の特長： - 長寿命</p>	<p>半導体ピックアップ</p> <p>ダイヤモンドニードル [1 + 4] × [A + G + H + I]</p> <p>この用途の特長： - 長寿命</p>
					<p>半導体検査・測定</p> <p>ニードル [2 or 5 or 6 or 7] × [1]</p> <p>この用途の特長： - バラツキなき量産</p>

Continue!